

# 新产品发布

MMIC 表贴

## 宽带双平衡混频器-放大器

MDA4-752H+

0级 (LO功率为0 dBm) 2200 MHz至7500 MHz

### 优势

- L-I隔离度高, 61 dB典型值
- 本振功率低, 0 dBm
- 小尺寸封装, 4x4x1 mm



CASE STYLE: DG1847

**Pricing: \$11.95 (QTY 10)**

### 产品介绍

MDA4-752H+采用多芯片集成设计, 独立封装结构, 内部包含混频器、本振放大器(InGap HBT)和中频放大器(E-PHEMT)。在宽频带范围内具有平坦的变频增益和高IP3性能。此外, MDA4-752H+无需外部匹配元件, 即可获得宽频带范围内良好的输入和输入回波损耗。采用锡银镍镀层4x4mm MCLP封装, 并通过锡晶测试。

### 主要特征

特征	优势
频带宽, 2.2 GHz至7.5 GHz	适用于宽带系统和多种窄带系统中。通用性可有效减少器件库存。
IF频带宽, 0.03 MHz至1600 MHz	可用于第一级下变频(高中频如860 MHz)和第二级下变频(低中频如70 MHz)应用中。
变频增益, 4 dB至9 dB	内部集成低噪声IF放大器, 有效提升变频增益, 减少了对外部放大器的需要。
LO驱动功率要求低	通过内部集成LO放大器, MDA4-752H+可在低至-3 dBm的本振功率下工作, 使得该器件极其适合接收机应用。
LO-IF隔离带和RF-IF隔离度高, 在4 GHz至7.5 GHz可达50dB至65dB	当MDA4-752H+使用于推荐电路中时, 本身具有极高的隔离度, 减少了对进一步滤波的需要。
4 mmx4 mm, 24个引脚的MCLP封装	将混频器, LO放大器和IF放大器集成于单一封装中, 可有效节省PCB布局空间。此外, MCLP封装具有低电感特性, 可重复性好, 与PCB板热接触良好的特性。

**Mini-Circuits®**  
ISO 9001 ISO 14001 AS 9100 CERTIFIED



**Mitron Inc.**  
Authorized Mini-Circuits Rep in China